

# ALPHA® HIFLO® SMG

Высокоочищенный брусковый припой для волновой пайки

## ОПИСАНИЕ

Брусковый припой HiFlo SMG произведен из высокоочищенных исходных материалов, с использованием запатентованных добавок, снижающих вязкость припоя и уменьшающих шлакообразование. Результатом является очень чистый припой с высокой текучестью, практически не содержащий примесей посторонних металлов и оксидов, в результате использования которого образуется минимум оксидов. Кроме минимального уровня шлакообразования также снижается количество дефектов пайки, таких как непропаи, перемычки, «сосульки» припоя и становится возможна пайка электронных сборок с малым шагом. Является идеальным для плат с высокой плотностью компонентов, позволяет увеличить производительность и выход годных, и снизить затраты на обслуживание машины волновой пайки.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- *Увеличение производительности линии:* уменьшение себестоимости продукции.
- *Минимизация шлакообразования:* экономия на времени, необходимом для обслуживания машины, уменьшение потребления припоя.
- *Уменьшение количества перемычек:* меньшее количество доработки, увеличение выхода годных и, как следствие, уменьшение себестоимости и повышение качества изделий.
- *Пайка плат с высокой плотностью компонентов:* возможность использования одного процесса для пайки изделий с любой плотностью компонентов.
- *Пайка при меньшей температуре:* меньшая температура означает меньшее окисление и снижение затрат на припой.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Припой HiFlo SMG идеален для использования в любых системах волновой и селективной пайки, включая оборудованные генераторами азота.

Припой HiFlo SMG идеален для следующих условий применения:

- Высокие объемы волновой пайки.
- Пайка изделий, требующих наличие в машине двойной и чип-волны
- Платы с высокой плотностью компонентов.
- Мелкий шаг выводов компонентов.

Рекомендуемая температура припоя в ванне – 240-250°C. Для подбора подходящего флюса используйте руководство по выбору флюса Alpha. Возможен сбор шлака (зависит от региона расположения потребителя).

## ФОРМА ВЫПУСКА

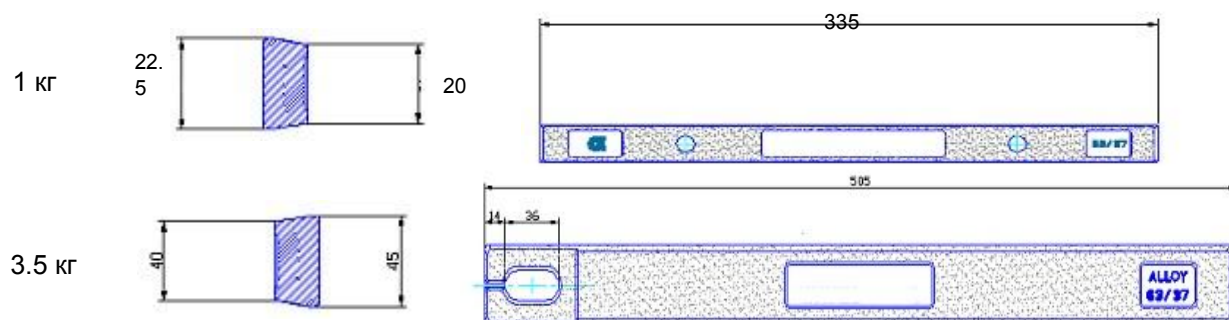
Брусковый припой HiFlo доступен в форме брусков массой 1 кг, либо брусков массой 3,5кг с кольцом для машин с автоматической подачей припоя.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Обратитесь к документу MSDS для правильного обращения с припоем и инструкциями по безопасности.

## РАЗМЕРЫ БРУСКОВ

Все размеры в мм.



## СПЕЦИФИКАЦИИ

Нижеприведенная таблица содержит сравнение максимальных уровней примесей в припое Hiflo SMG в сравнении со стандартами J-STD-006A, ISO9453 и JIS Z3282.

ЭЛЕМЕНТ	Hiflo SMG	ISO9453 Alloy 1A <sup>1</sup>	J-STD-006A Sn63Pb37C <sup>2</sup>	JIS Z3282A H63E <sup>3</sup>
Sn	62.5 – 63.5	62.5 – 63.5	62.5 – 63.5	62.5 – 63.5
Pb	Остальное	Остальное	Остальное	Остальное
Sb	0.05 макс	0.05 макс	0.05 макс	0.05 макс
Cu	0.005 макс	0.05 макс	0.08 макс	0.05 макс
Zn	0.001 макс	0.001 макс	0.003 макс	0.001 макс
Fe	0.001 макс	0.02 макс	0.02 макс	0.02 макс
As	0.005 макс	0.03 макс	0.03 макс	0.03 макс
Ni	0.002 макс	Не определен	0.01 макс	Не определен
Bi	0.005 макс	0.05 макс	0.10 макс	0.05 макс
Cd	0.001 макс	0.002 макс	0.002 макс	0.002 макс
Ag	0.005 макс	Не определен	0.10 макс	Не определен
Al	0.001 макс	0.001 макс	0.005 макс	0.001 макс
In	0.005 макс	Не определен	0.10 макс	Не определен

Все значения в %

- ISO 9453: 1990  
Мягкие припои – химический состав и форма выпуска.
- J-STD-006A: Май 2001  
Требования к припоям для пайки электроники и припоям без флюсов.
- JIS Z3282: 1999  
Мягкие припои – химический состав и формы выпуска.